

tesa® HAF 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป HAF ฟิล์มที่ติดโดยการกระตุ้นด้วยความร้อน สีขุ่น หนา 40 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® HAF 8440 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน กาวสองหน้า โปร่งใส ประกอบด้วย thermoplastic copolyamide

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพเชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับ PVC, ABS, PET และ PC การ์ด
- สามารถใช้การได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- ไม่สามารถมองเห็นบน assembled card

สาขาการใช้งาน

tesa® HAF 8440 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการฝังชิพโมดูลลงในสมาร์ตการ์ด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|----------|
| • ตัวเทป | none | • ประเภทของแผ่นลอก | glassine |
| • ประเภทของกาว | copolyamide | • ความหนารวม | 40 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- แรงยึดเกาะ 12 N/mm²
(แรงเนียนแบบไดนามิก)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องจักรที่จะใช้เบื้องต้น

โปรดทราบว่าค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิพโมดูล และข้อกำหนดของลูกค้า

1. การติดเคลือบเบื้องต้น:

ช่วงการติดเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบติดบนสายพานโมดูล ขั้นตอนนี้สามารถทำได้แบบอินไลน์หรือออฟไลน์

ขั้นตอนเคลือบติดเบื้องต้นนี้ไม่ส่งผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของเทป

การตั้งค่าเครื่องจักร:

- อุณหภูมิ 130 - 140 °C
- แรงกดทับ 2-3 บาร์
- เวลา 2.5 ม./นาที

2. การฝังโมดูล:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8440>

tesa® HAF 8440

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระหว่างการฝังโมดูล โมดูลที่เคลือบติดเทปแล้วจะถูกDie-cut จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าไปในหลุมของบัตเตอร์และติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตเตอร์ด้วยความร้อนและแรงกด สำหรับขั้นตอนนี้ การจัดการที่แน่นอนในขั้นนี้ขึ้นอยู่กับชนิด implanting line ที่ใช้ สามารถใช้ทั้งแบบกดขั้นตอนเดียวและแบบกดอัดหลายๆครั้ง ปัจจุบันวิธีแบบกดอัดหลายๆครั้งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป

การตั้งค่าเครื่อง - กดอัดขั้นตอนเดียว:

- อุณหภูมิ 180–220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการกดอัดหลายๆครั้ง(การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) - การตั้งค่าเครื่อง:

- อุณหภูมิ 180 – 220 °C
- แรงกด 65 N/โมดูล
- เวลา 2 x 0,7 วินาที /3 x 0.5 วินาที

¹ อุณหภูมิตามที่วัดภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน สำหรับวัสดุบัตเตอร์ที่แตกต่างกันมีการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกัน มีแนะนำดังนี้:

- *PVC 180 - 190 °C
- *ABS 180 - 190 °C
- *PET 190 - 200 °C
- *PC 200 - 220 °C

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝังชิปโมดูล ควรใช้การตั้งค่าเครื่องที่แตกต่างกัน

ค่าความแข็งแรงของการติดได้รับการทดสอบภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

ค่าที่ได้ได้รับการันตีจากการทดสอบด้วยจำนวนจำกัดในแต่ละชุดการผลิต (วัสดุ: ชิ้นงานทดสอบ Etchedอะลูมิเนียม/สภาวะการติด: อุณหภูมิ = 120 °C; p = 10 บาร์; เวลา = 8 นาที)

สภาพการเก็บรักษาเป็นไปตามมาตรฐานอายุการใช้งาน tesa® HAF

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่างไรก็ดี เป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8440>